

特点:

- 输出频率: 1090MHz
- 输出频率温度稳定度: $\leq \pm 350$ ppm
- 输出功率: 典型值 $\geq +6$ dBm
- 工作温度: $-55 \sim +85^\circ\text{C}$
- 封装尺寸: $20 \times 12.8 \times 5.7$ (max)mm
- 产品执行标准为 GJB8481-2015

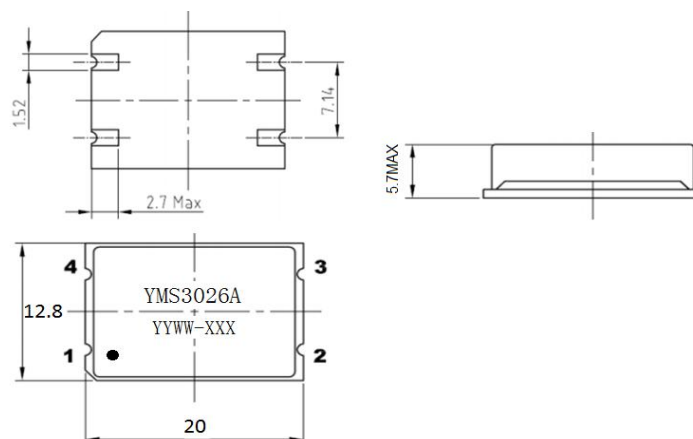
图片
性能参数:

参数名称		参数值			单位	备注	
		MIN	TYP	MAX			
输出频率	F		1090		MHz		
初始频差				± 150	ppm		
温度频率稳定度				± 350	ppm	$-55 \sim +95^\circ\text{C}$	
输入特性	输入低电平	VG	0	1.5	V	满足脉冲测试	
	输入高电平	VG	3.5	5	V		
	输入负载		10pF//10kOhm				
	上升沿	Ton		15	40		ns
	下降沿	Toff		15	30		ns
射频输出	信号类型		正弦波				$R_L = 50\Omega$
	输出信号幅度		6	7		dBm	@VG > 3.5V
	输出关闭			-50	-45	dBm	@VG < 1.5V
	谐波			-44	-40	dBc	
电源	Vs	4.75	5	5.25	V		
电流	输出开			35	120	mA	@VG > 3.5V
	输出关			10	35	mA	@VG < 1.5V
重量				5	gram		

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
电源电压	5.25	V	贮存温度	$-55 \sim +100$	$^\circ\text{C}$

封装外形图:

 单位: mm 公差: ± 0.2 mm


字符标志:

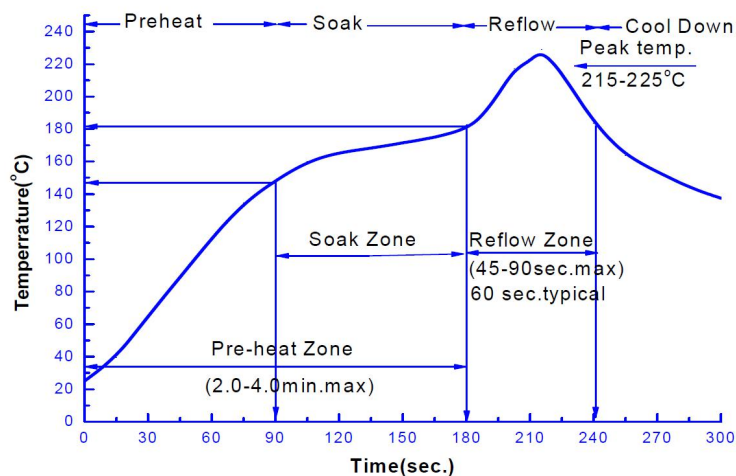
YMS3026A	产品型号
●	1脚
YYWW	批次号
XXX	序列号
备注	产品标识以实物为准

引脚定义:

引脚	符号	定义
1	VG	逻辑输入
2	GND	接地
3	RF OUT	射频输出
4	V _s	电源供电

产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品禁止采用超声波清洗，避免内部元器件及焊点受力出现开裂影响可靠性。
3. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
4. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃ 回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。